

15:50 Uhr **Pause**

16:15 Uhr **Einbettung von Bauelementen in Leiterplatten
– von modularer Sensorik bis zu Leistungselektronik**
Hr. Andreas Ostmann, Dr.-Ing. Dipl.-Phys., Gruppenleiter
Einbettung und Substrattechnologien, Fraunhofer IZM,
D-Berlin

Die Einbettung elektronischer Bauelemente in Leiterplatten hat sich als sehr vielseitige und zuverlässige Methode in der Herstellung miniaturisierter Elektronik etabliert. Führende Hersteller schaffen es mittels dieser Technologie, kleinstformatige Module mit individuell angepassten Komponenten und Abläufen in Grossserien herzustellen. Der Vortrag gibt einen Überblick zu den heute verfügbaren Embedding-Technologien und ihren Einsatzgebieten. Speziell werden Beispiele zu Sensor-Modulen mit eingebetteten SMD-Bauteilen sowie zu Embedded-Leistungsmodulen für Elektrofahrzeuge gezeigt.

17:00 Uhr **Injektverfahren**
Hr. Peter Strohm , Geschäftsführer
SweeTec Limited, D-Endingen

Vorteile des Inkjetverfahrens wie Einsparpotenzial, Unterschiede zu bisherigen Verfahren, Vorteile beim Drucken und Bestücken. Wichtige technische Details zu Inkjetsystemen, warum welche Faktoren für ein gesichert gutes Druckergebnis wichtig sind.

17:40 Uhr **Schlusswort**

17:45 Uhr **Apéro mit anschliessendem Nachtessen**
und gemütlichem Beisammensein

Einladung



Schweizerische Gesellschaft
für Oberflächentechnik
Société Suisse de Traitement
de Surface

ZUM TRADITIONELLEN SGO- LEITERPLATTENSEMINAR

6. Juni 2018

Dank der hohen Kompetenz und Innovationskraft im Schweizer Leiterplattenmarkt dürfen wir heute wieder von prosperierenden Unternehmen sprechen.

Die zunehmende Digitalisierung stellt zwar neue Herausforderungen, sie ebnet uns aber den Weg zu einer hocheffizienten Fertigung.

Wir sind gespannt auf interessante Vorträge und schauen einem regen Austausch in unserer „Leiterplatten-Familie“ entgegen.

Datum: Mittwoch, 6. Juni 2018

Zeit: 13:30 Uhr

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus,
im Spilhöfler
8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Kosten: Inkl. Kaffee, Apéro + Nachtessen
(ohne Getränke)

Nur Tageskasse SGO Mitglieder Fr. 70.-
Nichtmitglieder Fr. 110.-

Anmelden unter: www.sgo-sst.ch - Fachanlässe

Fortsetzung Präsentation Hr. Dr. Eric Scheidegger

- Die Schweiz als Weltmeisterin der Anpassung an den Strukturwandel
- Bisherige Erfahrungen machen Mut!
- Die Arbeit geht uns mit Sicherheit nicht aus!

14:30 Uhr **Flex- und Stretch-Leiterplatten für Smarte Elektronik**

Dr. Alina Schreivogel, Forschung und Entwicklung
Würth Elektronik GmbH & Co. KG, D-Rot am See

In den nächsten Jahren steigt der Bedarf an Produkten in flexiblen Substraten mit intelligenten Funktionen, die mit hochintegrierten Siliziumchips realisierbar sind, kombiniert mit Sensorik, Energieversorgung oder Aktorik. Die Würth Elektronik CBT arbeitet seit einigen Jahren an der Entwicklung von dehnbaren Leiterplatten. Um die Dehnbarkeit der Leiterplatten zu realisieren, werden statt starren glasfaserverstärkten epoxidharz-basierten Materialien oder flexiblen Polyimidfolien nun dehnbare Substrate aus Polyurethan eingesetzt und geradlinige Leiterbahnen durch mäandergeformte Leiter ersetzt. In diesen neuartigen elektronischen Systemen werden Eigenschaften wie Flexibilität, Elastizität und Biegeschlaffheit vereint.

Programm

13:30 Uhr **Begrüssung**
Hr. Peter Weber, Head of Technology
GS Swiss PCB AG, CH-Küssnacht

Marktanalyse Europa / speziell D / A / CH
Hr. Hansruedi Fischer, Verkaufsleitung D/F
Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht

13:45 Uhr **Arbeitsmarkt: wer gewinnt – wer verliert?**
Hr. Dr. Eric Scheidegger, Leiter Direktion für Wirtschaftspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, CH-Bern

- Digitalisierung hat vor 40 Jahren eingesetzt
- Digitalisierung gilt als Chance
- Digitalisierung der Arbeitswelt als Sorge von Arbeitnehmern
- Digitalisierung ist kein Nullsummenspiel mit „Gewinnern“ und „Verlierern“

15:15 Uhr **Direct Immersion Gold „DIG“**
Hr. Remo Fischer, Betriebsleiter, Mitglied GL
Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht

Die Leiterplattenindustrie nähert sich immer mehr der Halbleitertechnik an. Mit dem DIG-Verfahren wird ein weiterer Meilenstein in der Fine-Line-Technik und Mischbestückung geschaffen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung des DIG-Prozesses ist es gelungen, ein breites Spektrum an Basismaterialien zuverlässig und porenarm zu beschichten.